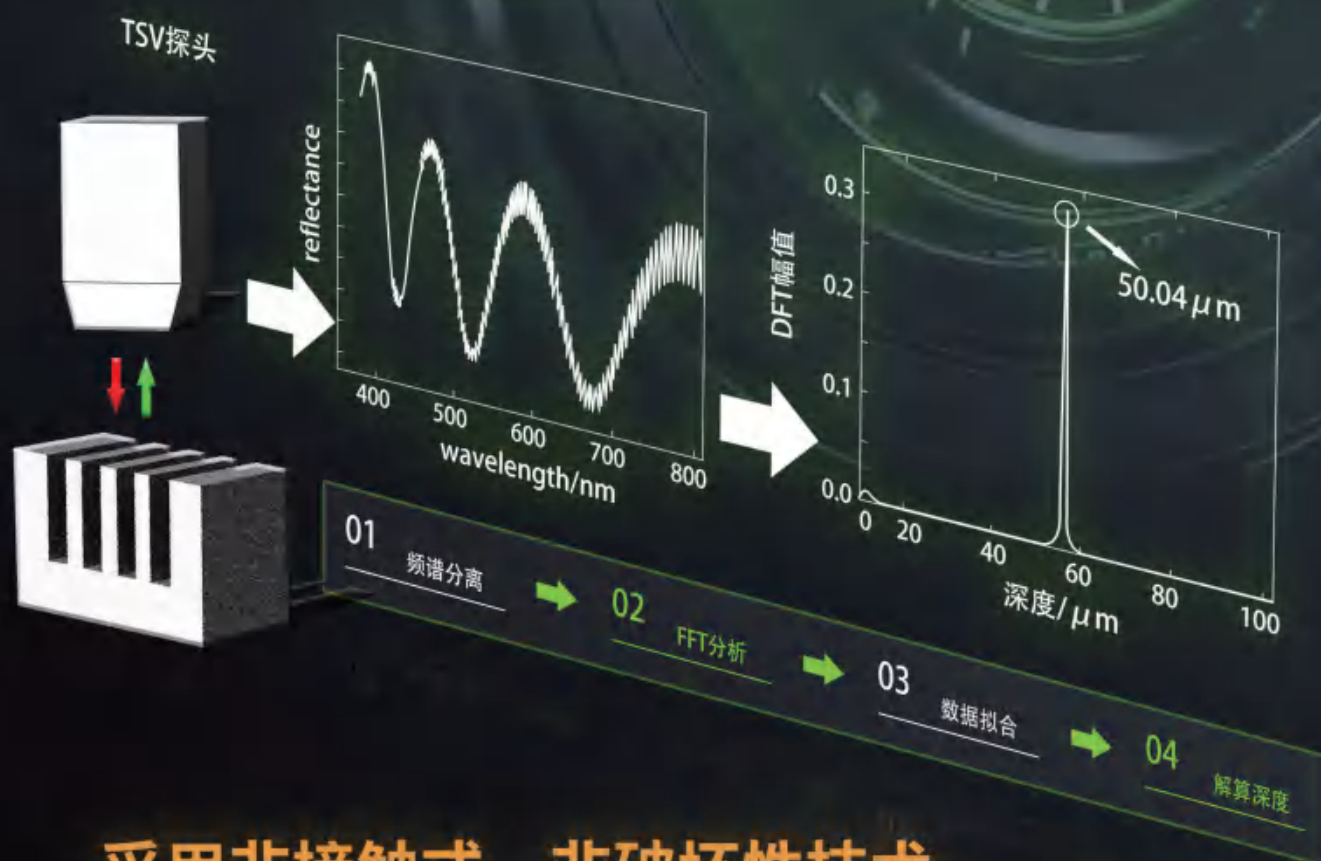


$<2\mu\text{m}$
最小开口宽度

$>300\mu\text{m}$
最大测量深度

1:50
最大深宽比

360° $1\mu\text{m}$
最小分辨率

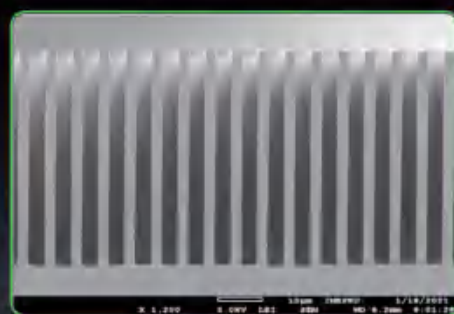


采用非接触式、非破坏性技术
可测TSV、TGV等多种微孔槽结构



Tigris系列是一款专为高深宽比TSV检测设计的光学测量系统，采用非接触式、非破坏性技术，提供高效、精准的TSV深度测量解决方案，快速帮助半导体制造商发现缺陷，助力HPC和AI芯片的先进制程发展。

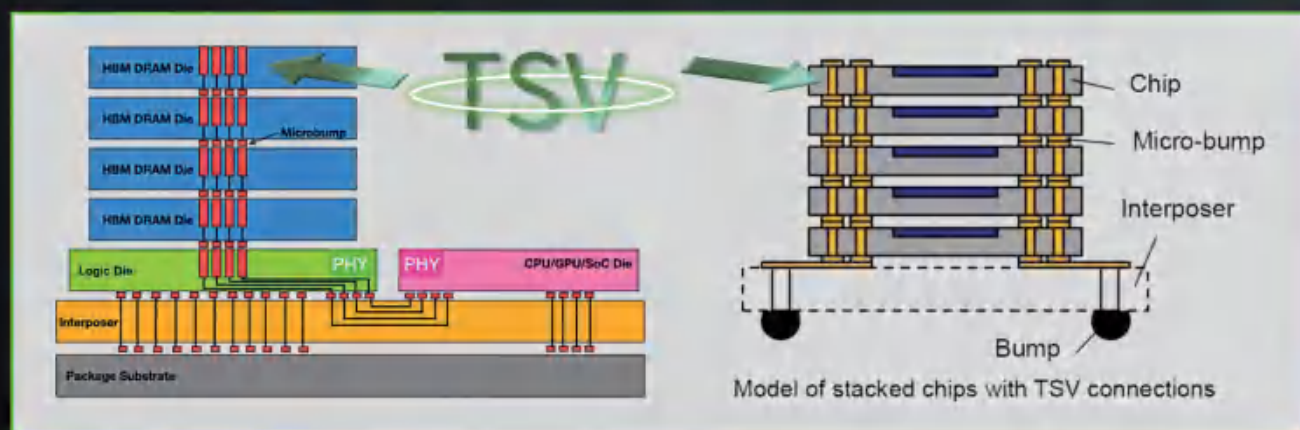
● 经典应用



MENS典型高深度宽比结构



IC典型高深度宽比结构：TSV



● 技术参数

产品参数	Tigris系列
测试类型	深度测量
光源类型	宽光谱光源
适配晶圆尺寸	8 英寸（可选 12 英寸）
检测项目	TSV CD、阶高、晶圆厚度、三维可视化
TSV CD	$\phi 3 \sim 20 \mu m$
最大深宽比	1:50
工作距离	40mm
镜头	5X, 20X(或其他选择); 聚焦镜头
系统配置	XYZC (400x350x10mm, 360°) $1 \mu m$ 分辨率
洁净度等级	Class 100
核心探头尺寸	40*40*60cm

- 独特光学设计，提高检测精度
- 高效信号处理，提高检测速度
- 采用白光检测，降低检测成本
- 在线检测技术，提高生产效率